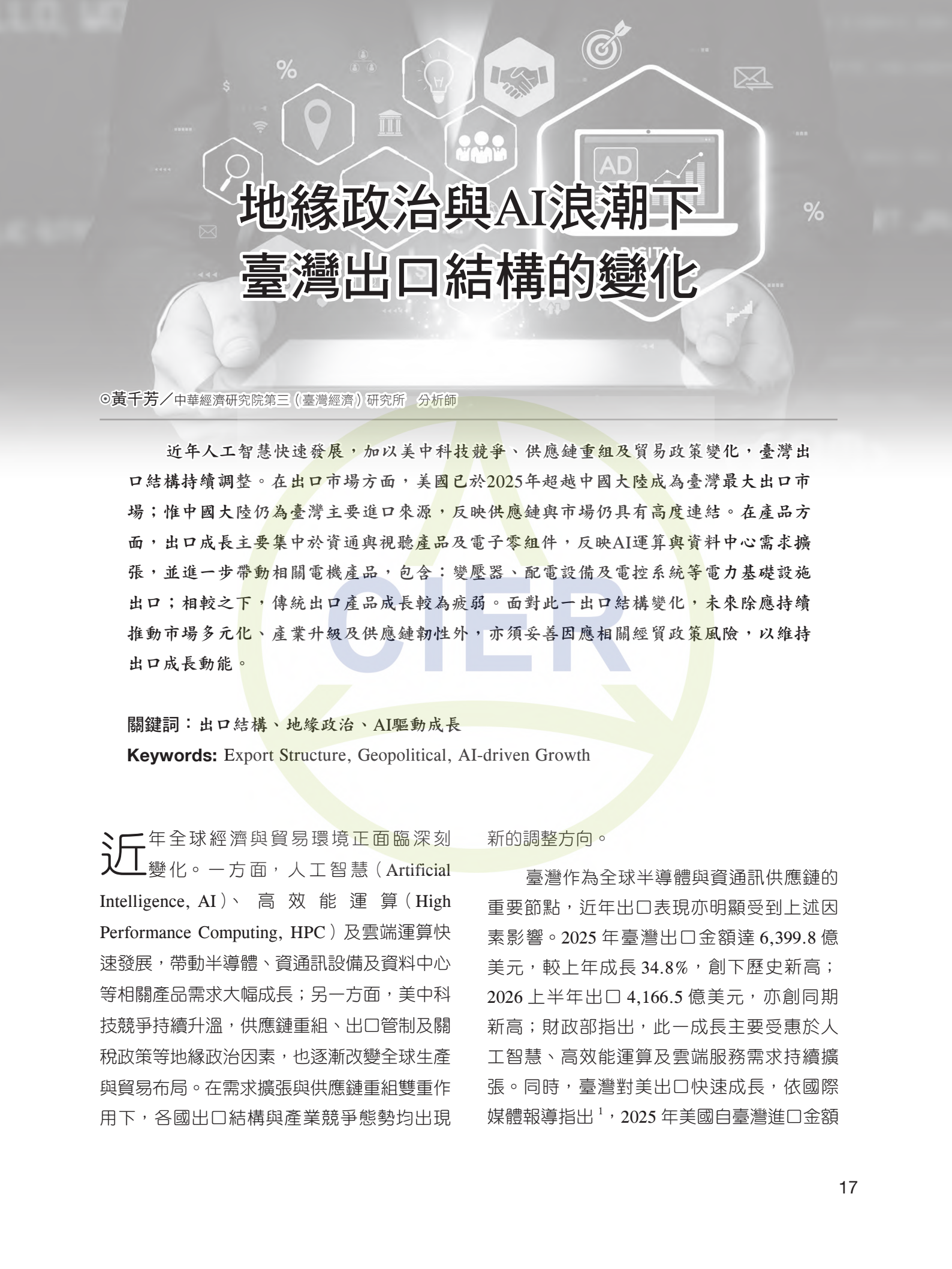




地緣政治與AI浪潮下 臺灣出口結構的變化

◎黃千芳／中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所 分析師

近年人工智慧快速發展，加以美中科技競爭、供應鏈重組及貿易政策變化，臺灣出口結構持續調整。在出口市場方面，美國已於2025年超越中國大陸成為臺灣最大出口市場；惟中國大陸仍為臺灣主要進口來源，反映供應鏈與市場仍具有高度連結。在產品方面，出口成長主要集中於資通與視聽產品及電子零組件，反映AI運算與資料中心需求擴張，並進一步帶動相關電機產品，包含：變壓器、配電設備及電控系統等電力基礎設施出口；相較之下，傳統出口產品成長較為疲弱。面對此一出口結構變化，未來除應持續推動市場多元化、產業升級及供應鏈韌性外，亦須妥善因應相關經貿政策風險，以維持出口成長動能。

關鍵詞：出口結構、地緣政治、AI驅動成長

Keywords: Export Structure, Geopolitical, AI-driven Growth

近年全球經濟與貿易環境正面臨深刻變化。一方面，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、高效能運算（High Performance Computing, HPC）及雲端運算快速發展，帶動半導體、資通訊設備及資料中心等相關產品需求大幅成長；另一方面，美中科技競爭持續升溫，供應鏈重組、出口管制及關稅政策等地緣政治因素，也逐漸改變全球生產與貿易布局。在需求擴張與供應鏈重組雙重作用下，各國出口結構與產業競爭態勢均出現

新的調整方向。

臺灣作為全球半導體與資通訊供應鏈的重要節點，近年出口表現亦明顯受到上述因素影響。2025年臺灣出口金額達6,399.8億美元，較上年成長34.8%，創下歷史新高；2026上半年出口4,166.5億美元，亦創同期新高；財政部指出，此一成長主要受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務需求持續擴張。同時，臺灣對美出口快速成長，依國際媒體報導指出¹，2025年美國自臺灣進口金額

大幅增加，2026 年 5 月，臺灣更超越中國大陸，成為美國第三大進口來源國，僅次於墨西哥與加拿大。由於美國政府持續重視對外貿易失衡的現象，臺灣對美的貿易順差擴大，未來可能進一步成為影響臺美貿易政策及雙邊經貿關係的重要因素。

在此背景下，出口總額的快速成長是否伴隨出口結構的改變？AI 需求與地緣政治因素如何共同影響出口市場及產品組成？出口結構的變化及其背後驅動因素，值得進一步探討。本文以財政部貿易統計及相關產業資料為基礎，從出口市場與產品兩個面向分析近年臺灣出口結構之變化，檢視 AI 需求擴張與地緣政治對出口市場及產品組成之影響，並據此歸納近年臺灣出口結構轉變的主要特徵，最後提出相關結論與建議。

出口市場結構的轉變：地緣政治下的雙軸格局

依財政部公布之貿易統計，臺灣對美出口比重於 2025 年攀升至 31.0%，對中國大陸（含香港）之出口比重則降至 26.6%，此為近二十年以來美國首度超越中國大陸（含香港），成為臺灣最大出口市場。就出口成長動能觀察，2026 年 1 至 6 月臺灣對美出口達 1,333.1 億美元，占整體出口 32.0%，年增 69.0%，明顯高於同期整體出口 47.1% 的增幅，顯示對美出口已成為臺灣整體出口成長的重要動能；另一方面，對新南向國家出口亦呈現強勁成長，同期出口額達 992.2 億美元，年增 55.4%，不僅高於整體出口成長率，

亦略高於對中國大陸（含香港）的 991.4 億美元（見圖 1、圖 2）。

值得注意的是，此一市場結構轉變並非典型的「市場替代」或「供應鏈脫鉤」。2026 年 1 至 6 月臺灣對中國大陸（含香港）出口年增率仍達 25.2%；同期臺灣自中國大陸進口 595.5 億美元，年增 37.8%，中國大陸（含香港）仍為臺灣最大進口來源，貿易仍呈現順差。換言之，臺灣一方面透過中國大陸供應鏈參與全球中間財貿易，另一方面藉由美國市場擴大終端需求出口，形成「中國供應鏈與美國市場」的雙軸貿易格局。部分研究機構將此一現象歸納為「全球化改道」而非「全球化終結」：美國扮演 AI 終端需求核心角色，中國大陸持續掌握中間財與成熟電子供應能力，臺灣則憑藉半導體與 AI 伺服器供應鏈優勢，同時受惠於兩端之需求成長²。

在此一格局下，地緣政治風險的傳遞途徑主要有三：第一，美國關稅政策之不確定性，包含：對等關稅稅率調整、半導體相關關稅豁免範圍，以及美國政府要求半導體業者於美國本土生產一定比例晶片之政策方向，均可能影響臺灣對美出口之長期穩定性；第二，原產地規則與洗產地查核之強化，可能增加臺灣廠商轉單、轉單生產布局之合規成本；第三，兩岸關係與供應鏈「去風險化」趨勢，促使部分臺商調整在中國大陸與南向國家之產能配置，惟目前觀察此一調整仍屬漸進，尚未出現大規模產能移轉。整體而言，出口市場結構之轉變雖具有明確的地緣政治



驅動色彩，但臺灣廠商透過市場多角化與供應鏈雙軌布局，一定程度緩解對單一市場過度依賴之風險。

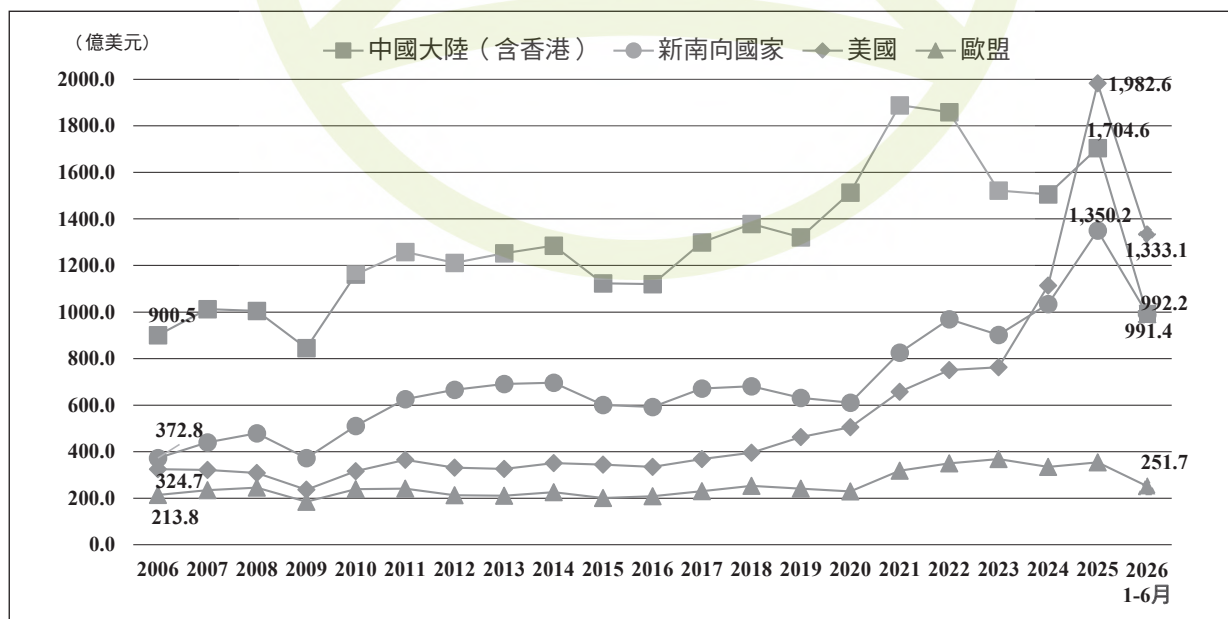


注1：新南向國家為東帝汶以外的東協10國、南亞6國、澳大利亞及紐西蘭。

注2：配合2021年1月英國脫離歐盟正式生效，故歐盟範圍亦不含英國。

資料來源：財政部（2026年8月），作者繪製。

圖1 我國主要出口國及出口占比（2006-2026）



注1：新南向國家為東帝汶以外的東協10國、南亞6國、澳大利亞及紐西蘭。

注2：配合2021年1月英國脫離歐盟正式生效，故歐盟範圍亦不含英國。

資料來源：財政部（2026年8月），作者繪製。

圖2 我國主要出口國及出口金額（2006-2026）

產品出口表現的分化：AI驅動的成長動能重組

從出口產品結構觀察，依財政部 2026 年 8 月最新統計，2025 年資通與視聽產品出口 2,511.5 億美元，年增 89.5%，占總出口比重由 2023 年的 19.3% 大幅升至 39.2%；電子零組件出口則達 2,221.8 億美元，年增 25.4%，占比為 34.7%。兩者合計出口金額達 4,733.3 億美元，占整體出口約 74%，顯示近年臺灣出口擴張高度集中於電子及資訊通信相關產品。此一集中趨勢延續至 2026 年上半年，出口總額達 4,166.5 億美元，年增 47.1%；其中，資通與視聽產品及電子零組件仍分別維持 83.9% 及 42.4% 的高成長，顯示出口成長動能並未隨整體出口規模擴大而明顯分散。有關我國主要出口貨品類別，請參考附表。

此一結構變化與全球 AI 投資快速擴張密切相關。尤其，生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, GenAI）的快速商業化，帶動全球雲端服務業者持續擴大資本支出，並推升 AI 伺服器、高效能運算晶片、記憶體及相關電子零組件的需求。臺灣在半導體、電子零組件、伺服器及資通訊設備等領域具備完整供應鏈優勢，因此成為此波 AI 投資週期的重要受益者。換言之，當前電子及資通訊產品出口的快速成長，並非單純反映傳統科技產品景氣回升，而是全球 AI 基礎建設投資擴張所帶動的新一輪需求週期。隨著大型雲端服務業者持續擴充資料中心及 AI 運算能

力，積體電路、伺服器、記憶體及其他關鍵電子零組件仍可望維持臺灣出口成長的核心地位。

相較之下，與 AI 投資連結較弱的傳統出口產品，成長表現明顯落後。2025 年基本金屬及其製品、塑膠橡膠製品出口分別年減 2.1% 及 8.1%；2026 年上半年雖轉為小幅成長 1.2% 及 1.5%，但比起資通與視聽產品及電子零組件的高速成長，復甦幅度仍相當有限。此一差距顯示，當前出口成長並非各類產品同步復甦，而是呈現由 AI 相關需求所帶動的明顯結構性分化。傳統產品需求仍主要受到全球製造業景氣、消費需求及原物料循環影響，此外，中國大陸部分產業產能過剩外溢所形成的價格與競爭壓力，以及美國關稅政策與全球貿易政策變化所增加的不確定性，亦使相關產品需求復甦相對有限。

值得注意的是，AI 所帶動的出口需求並未停留在晶片、伺服器及其他運算設備，而是逐步沿著供應鏈向資料中心的電力及周邊基礎設施擴散。隨著全球資料中心及半導體廠持續擴產，對穩定且高容量電力供應的需求同步增加，進而帶動變壓器、氣體絕緣開關設備（GIS）、配電盤及電控系統等產品需求。這項變化的重要意義在於，AI 所創造的出口機會已由運算設備進一步延伸至電力基礎設施，使部分過去較少被視為科技出口核心的產品，在出口結構中的重要性逐步提升。

電機產品即是此一需求外溢的重要代表。雖然其出口規模仍明顯低於電子零組件



及資通與視聽產品，在臺灣整體出口中的占比相對有限，但近年成長速度已明顯加快。依財政部統計，電機產品出口在 2023 年及 2024 年分別年減 17.3% 及小幅成長 1.3%，2025 年轉為年增 13.4%，2026 年上半年更進一步成長 22.9%，呈現與多數傳統產品不同的成長軌跡。此一表現顯示，電機產品雖尚非臺灣出口的主要成長來源，但其需求已逐步受到資料中心、半導體廠及電力基礎設施投資帶動，成為觀察 AI 需求外溢效果的重要產品類別。

海外資料中心投資則是帶動相關電機產品與電力設備需求的重要驅動因素。北美雲端服務業者持續擴大 AI 及資料中心資本支出，帶動全球資料中心建置需求。依 TrendForce 2026 年 5 月最新評估³，全球九大雲端服務業者 2026 年資本支出預估達 8,300 億美元，年增 79%，顯示 AI 基礎設施投資仍維持強勁成長；另預估 2026 年全球資料中心電力總容量將達 155GW，年增約 29%，除帶動 AI 伺服器及網通設備需求外，也同步推升電力供應、配電及相關基礎設施需求。

進一步觀察資料中心投資所帶動的電力設備需求，其成長邏輯與 AI 核心電子產品有所不同。變壓器、配電設備及電控系統等產品，多與資料中心、半導體廠及電網等大型基礎建設專案相連結，從規劃、採購至安裝通常需經歷較長週期，設備使用年限亦相對較長，因此需求並非隨 AI 技術快速迭代而立

即變動，而是取決於資料中心擴建、半導體產能投資及電網升級等中長期基礎建設需求。換言之，AI 除直接創造晶片、伺服器等核心運算產品需求外，也透過資料中心建置與能源基礎設施擴張，帶動電力設備等周邊產業形成另一波結構性需求。

從上述變化來看，AI 對臺灣出口的影響，其一是以積體電路、伺服器、記憶體及其他電子零組件為核心的 AI 運算產品，直接受惠於全球 AI 模型訓練、推論及雲端運算需求快速擴張，具有成長速度快、出口規模大等特徵，但同時也較容易受到科技景氣循環及國際大廠資本支出調整影響；其二則是由變壓器、配電設備、電控系統等構成的 AI 基礎設施，需求來自資料中心、半導體廠及電網等大型投資，雖然與 AI 的直接關聯程度較低，卻具有訂單週期長、需求能見度高及基礎建設投資持續性較強等特徵。

相較之下，第三類產品則與 AI 投資週期的連結較為有限，仍主要受到全球製造業景氣、消費需求及供需循環等因素影響，包括：基本金屬及其製品、塑膠橡膠製品等傳統出口產品。此類產品目前尚未明顯受惠於 AI 投資所帶動的新增需求，出口表現相對疲弱，也使臺灣不同產品間的成長差距進一步擴大。由此觀察，AI 需求快速擴張之下，臺灣出口已逐步呈現 AI 運算產品高速成長、AI 基礎設施產品需求擴散，以及傳統產品相對疲弱的差異化表現，形成出口成長動能明顯分化的現象。

附表 我國主要出口貨品類別（2023-2026）

單位：億美元；%

項目	2023年			2024年			2025年			2026上半年		
	出口金額	年增率	占比	出口金額	年增率	占比	出口金額	年增率	占比	出口金額	年增率	占比
總計	4,324.2	-9.8	100.00	4,749.3	9.8	100.00	6,399.8	34.8	100.00	4,166.5	47.1	100.00
資通與視聽產品	833.6	28.9	19.3	1,325.0	59.0	27.9	2,511.5	89.5	39.2	1,873.7	83.9	45.0
電子零組件	1,787.0	-10.7	41.3	1,772.2	-0.8	37.3	2,221.8	25.4	34.7	1,405.0	42.4	33.7
基本金屬及其製品	287.4	-22.0	6.6	285.2	-0.8	6.0	279.3	-2.1	4.4	146.4	1.2	3.5
機械	242.1	-15.2	5.6	240.6	-0.6	5.1	257.5	7.0	4.0	142.4	17.8	3.4
化學品	184.2	-21.5	4.3	182.8	-0.7	3.8	182.3	-0.3	2.8	94.3	2.7	2.3
塑膠、橡膠及其製品	199.6	-23.3	4.6	195.9	-1.9	4.1	180.0	-8.1	2.8	93.6	1.5	2.2
電機產品	131.2	-17.3	3.0	133.0	1.3	2.8	150.8	13.4	2.4	88.6	22.9	2.1
礦產品	146.2	-26.0	3.4	139.5	-4.6	2.9	139.2	-0.2	2.2	81.2	15.8	1.9
光學及精密儀器	129.7	-21.5	3.0	112.6	-13.2	2.4	124.0	10.2	1.9	64.4	9.4	1.5
運輸工具	124.4	-25.2	2.9	108.7	-12.6	2.3	103.9	-4.4	1.6	50.8	-3.5	1.2

注：電機產品涵蓋範圍廣泛，包括：電動機（馬達）、發電機、變壓器、靜電式變流器（包括：電源供應器及不斷電系統等）、電池、車燈、電線及配線器材等，其中變壓器、配電設備及電控系統等產品，與資料中心及半導體廠對電力基礎設施的新增需求具有較直接的關聯。

資料來源：財政部（2026年8月），作者整理。

結語與建議

綜合市場別與商品別兩個層面觀察，當前臺灣出口結構之轉變，同時受到 AI 浪潮與地緣政治重組兩股力量驅動且相互強化。美中科技競爭與全球供應鏈去風險化趨勢，使美國逐漸成為臺灣最重要之終端需求市場；另一方面，AI 資料中心加速擴建，除帶動臺灣既有電子資通產品出口持續成長，亦進一步擴大電力設備等相關商品之需求。整體而

言，臺灣出口對美國市場及 AI 相關需求之集中度同步提高，不僅凸顯臺灣在全球 AI 供應鏈中之關鍵地位，也提高出口對單一市場及特定產業景氣循環之依賴程度。

尤其，出口快速集中於美國市場，也使臺美雙邊貿易失衡程度進一步擴大。美國長期將降低對外貿易逆差視為重要政策目標，對於對美享有大額貿易順差之經濟體，未來仍可能透過關稅、原產地規則、在地投資及產能要求等方式，要求重新調整雙邊貿易與



產業布局。雖然臺美雙方已於 2026 年 1 月就對等關稅稅率、半導體關稅待遇及投資承諾等議題完成協商，但若 AI 相關出口持續快速成長，臺美貿易失衡仍可能成為後續經貿政策協商之重要議題。因此，如何在維持臺灣 AI 供應鏈競爭優勢之同時，降低市場過度集中所衍生之政策與經貿風險，將是未來出口政策的重要課題。

為因應上述出口結構變化，本文建議後續政策可持續朝以下兩個方向推動：

第一，分散市場布局，提升出口韌性。

面對美國市場需求快速成長及臺美貿易失衡擴大，除深化臺美產業合作及供應鏈布局外，亦應持續加速拓展歐洲、東南亞及其他新興市場，透過市場多元化降低對單一市場之依賴；尤其可結合臺灣在半導體、AI 伺服器、資通訊及關鍵零組件等領域之供應鏈優勢，依不同市場之產業需求推動出口與投資布局，並將市場拓展與海外產能配置相互結合，以提升臺灣企業因應國際貿易政策變動之彈性。

第二，掌握 AI 需求擴散，拓展出口成長領域。AI 快速發展所帶動之需求已由晶片、伺服器及資通訊產品，逐步延伸至電力設備、能源管理及資料中心基礎設施，形成新的出口成長領域。政策上可進一步強化電子資通產業與電力設備、能源科技等產業之鏈結，協助具潛力之傳統產業切入 AI 基礎設施供應鏈，並結合國內電網建設、能源轉型及智慧

化需求，形成內需應用與出口拓展相互支撐之發展模式。同時，針對電子資通產業快速成長所形成之產業落差，應搭配傳統產業轉型升級、技術導入及人才培育措施，使 AI 所帶動之出口成長效益能進一步擴散至更多產業與勞動人口。

整體而言，臺灣出口結構之快速轉變，是 AI 發展與全球供應鏈重組共同作用下的結果。AI 不僅強化臺灣既有電子資通產業之出口優勢，也創造電力設備等新興商品之成長空間；然而，出口市場與產業結構同步集中，也使臺灣面臨較高之市場依賴與貿易政策風險。未來政策不宜僅著眼於擴大 AI 相關出口，而應同步推動市場多元化、產業鏈延伸及新興商品布局，在鞏固臺灣 AI 供應鏈優勢的基礎上，擴大 AI 成長效益之產業擴散與市場外溢，進而提升臺灣出口結構之韌性與長期成長動能。

附注

1. 世界新聞網（2026年08月01日）。台灣經濟勢如破竹專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」。 <https://www.worldjournal.com/wj/story/124277/9665983>
2. 中央通訊社（2026年06月27日）。台經社分析 關稅戰與AI供應鏈重組下台灣貿易趨勢。 <https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/437482>
3. TrendForce（2026年05月06日）。北美業者擴大投資AI資料中心助力，2026年全球九大CSP資本支出上調至8,300億美元。 <https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20260506-13032.html>